WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
TIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H05K 3/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

10. Juni 1999 (10.06.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/07659

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. November 1998 (27.11.98)

NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

MI97A002646

28. November 1997 (28,11,97)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): RESCO S.R.L. [IT/IT]; Via Massena, 2/A, I-20145 Milano (IT).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MATTHAES, Thomas [DE/IT]; Via Abbondio San Giorgio, 3, I-20145 Milano
- (74) Anwälte: BORCHERT, Uwe, R. usw.; Postfach 10 12 31. D-80086 München (DE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

(54) Title: METHOD AND MACHINE FOR PRODUCING FLEXIBLE AND SEMIRIGID PRINTED-CIRCUIT BOARDS

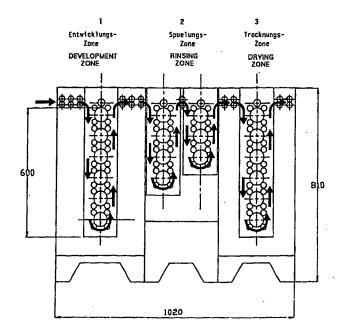
(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND MASCHINE ZUR HERSTELLUNG VON FLEXIBLEN UND HALBSTARREN LEITERPLAT-

(57) Abstract

The invention relates to a method and machine for producing printed-circuit boards, whereby the printed-circuit boards are vertically processed with a continuous vertical delivery system.

(57) Zusammenfassung

Verfahren und Maschine zur Herstellung von Leiterplatten, wobei die Leiterplatten, mit einem kontinuierlichen, senkrechten Fördersystem, senkrecht bearbeitet werden.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

1							~~	 •
1	AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
1	AM	Armenien .	FI	Finnland	LT	Litauen	SK -	Slowakei
1	ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
1	ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ı	ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
1	BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
	BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
1	BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
İ	BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
	BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ı	BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
ı	BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
1	BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
1	CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
ı	CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
ł	CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
	CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
l	CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
l	CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
l	CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
ļ	CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
l	CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
	DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
	DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
1	EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

PCT/EP98/07659

Verfahren und Maschine zur Herstellung von flexiblen und halbstarren Leiterplatten.

WO 99/29149

BESCHREIBUNG

von Herstellung flexiblen, halbstarren, einseitigen, doppelseitigen oder mehrschichtigen Leiterplatten werden zahlreiche Verfahren unterschiedliche Bearbeitungen verwendet. heute, zur Automatisierung von einigen Verfahren Bearbeitungen, insbesondere sogenannten Nassverfahren, werden Maschinen mit Foerderung durch Schlepprollen verwendet, welche die Leiterplatten durch die verschiedenen chemischen Verfahren waagrecht hindurchfoerdern, zur Herstellung die einige Maschinen von Leiterplatten kennzeichnen.

Die Menge von Leiterplatten , die pro Tag herzustellen sind, sowie die feste Dauer der chemischen Verfahren bestimmt die Laenge dieser Maschinen mit waagrechter Foerderung, die manchmal die Laenge von 30 oder 50 Meter erreichen kann. Ausserdem gewaehrleistet ein herkoemmliches Foerderungssystem mit waagrechten Rollen nicht immer eine einwandfreie Foerderung der sogenannten flexiblen Leiterplatten.

Vorliegende Erfindung bezieht sich hingegen auf

Maschinen, welche die Leiterplatten statt einem waagrechten, einem senkrechten Verfahren unterziehen, im Inneren von Becken, die chemische Produkte enthalten, mittels eines speziellen Systems von Rollen, die die Leiterplatten in den verschiedene Becken automatisch ein- und ausschalten.

Durch dieses System wird der Platzbedarf der Maschine oder der aus mehreren in Reihenfolge angeordneten Maschinen bestehenden Strassen um mindestens das vierfache herabgesetzt, in Bezug auf die bisher verwendeten Maschinen, wobei das besondere Foerderungssystem mit sehr naheliegenden Rollen die einwandfreie Foerderung von jeder Art von flexiblen Leiterplatten gewaehrleistet. Das gleiche Foerderungssystem sowie dieselbe Maschinenausfuehrung kann fuer folgende Verfahren verwendet werden: Entwicklung, Spuelung Trocknung von lichtempfindlichen, sowohl trockenen als auch fluessigen, Filmen; Entwicklung des fluessigen oder trockenen etch resist; Entwicklung trockenen soldermask; des fluessigen oder chemische Aetzung des Kupfers, aus dem Leiterplatten bestehen, oder chemische Aetzung von Metall, jedem anderen das sowohl

Herstellung von Leiterplatten als auch bei der Herstellung von gelochten oder gefraesten Einzelteilen mit chemischer Aetzung (chemical milling); Abstreifen (Entfernung) lichtepmfindlichen Films oder des sich vorher abgesetzten etch resist, sei es fluessig oder trocken ; Prozess der chemischen Mikroaetzung, Prozess der Desosyxadition von Kupfer oder von anderen Metallen, Prozess der Passivierung oder organischen Schutzes (organic coating), Abstreifens (der chemischen Prozess des Entfernung) des Zinnes oder des Bleies oder des Zinnes/Bleies, des Prozess · Buerstens der Metalloberflaeche, sei es dass sie aus Kupfer, Messing oder aus anderen Legierungen besteht, sei es nur mit Buersten sei es mit Buersten und Bimsstein; Prozess der Reinigung der Oberflaeche aus Kupfer, Messing oder aus anderen Legierungen mit Bimsstein und Wasser: Prozess der Metallisierung der Loecher der Leiterplatten; Prozess zur braunen oder schwarzen Oxydation der inneren Schichten multilayer: Prozess fuer etch back und fuer Entfernung des smear im allgemeinen; Prozess des chemischen oder elektrolytischen Galvanisierens; Prozesse fuer die Reinigung

innerhalb der Loecher mittels Ultraschall und chemischer Produkte; Prozesse der Reinigung mit Netzwasser oder mit entionisiertem Wasser, in Becken, die immer sauberes Wasser enthalten; Prozess des Bleichens (Desoxydation der Legierung Zinn/Blei); Prozess der Entfernung der Siebdruckfarben.

In Fig. 1 wird, beispielsweise, eine Maschine zur kaskadischen Spuelung Entwicklung, zur Trocknung des lichtempfindlichen Films. Gemaess diesem bekannten Verfahren geht die flexible Leiterplatte in eine waagrechte Position ueber, durch zwei Prozesskammern, in denen sie mittels der Entwicklungsfluessigkeit gespritzt wird, und anschliessend durch drei Entwicklungskammern, in denen sie mittels Wasser gespritzt wird und noch anschliessend durch eine Trocknungszone, dies immer auf waagrechter Weise, was deshalb den Nachteil einer sehr langen Maschine mit sich bringt, wobei die flexiblen Leiterplatten dazu neigen, aufwaerts oder abwaerts geschoben zu werden, durch die Duesen, die zwischen den Rollen spritzen.

Fig. la ist eine Draufsicht der Maschine gemaess Fig. 1. In dieser bekannten Maschine sind drei gesonderte Zonen erkennbar, und zwar eine Entwicklungszone (1), eine Spuelungszone (2) und ein Trocknungszone (3).

Bei dem erfindungsgemaessen Verfahren dagegen (Fig. 2) werden die Leiterplatten in ein Becken, das Wasser enthaelt, und in zwei Becken, wo sie mit Wasser gespuelt werden, sowie in einen dritten Bereich, wo sie getrocknet werden, senkrecht eingefuehrt.

flexiblen die bleiben diesen Becken Leiterplatten kontinuierlich in Beruehrung mit der in den Becken enthaltenen Fluessigkeit, anstatt durch die Duesen im Freien bespritzt zu werden, wobei ein besonderes Transportsystem das chemische Entwicklungsprodukt auf den Oberflaechen flexiblen Leiterplatten laufend bewegt erneuert. Dasselbe erfolgt in den waehrend in mit Wasser, Spuelung Trockungszonen die warme Luft zwangsweise um die flexiblen Leiterplatten geblasen wird.

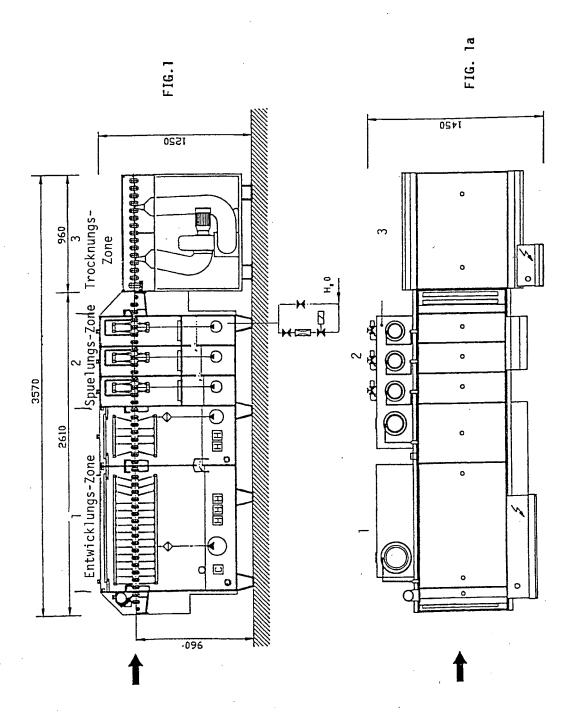
Bei einer gegebenen Foerdergeschwindigkeit,
bestimmt die feste Entwicklungszeit des etch
resist, das heisst die Zeit, waehrend der die
Leiterplatte in Beruehrung mit der
Entwicklungsfleussigkeit sein muss, bei den

herkoemmlichen waagrechten Maschinen, die Laenge Entwicklungskammer Entwicklungskammern; im Ausfuehrungsbeispiel gemaess Fig. beispielweise, 1200 erfindungsgemaessen Prozess dagegen, entwickelt sich die Laenge senkrecht, d.h. die Leiterplatte faehrt zunaechst um 600 mm innerhalb des Beckens herunter und steigt um weitere 600 mm wieder hinauf, insgesamt also um eine 1200 mm-Strecke (d.h. fuer die bestimmte Entwicklungszeit), jedoch mit einer waagrechten Strecke von lediglich 380 mm.

Gemaess der vorliegenden Erfindung wird die Foerderung der flexiblen Leiterplatten sowie der inneren Schichten (innerlayers) mittels Verwendung eines besonderen Foerderungssystems (Fig. 3), bei dem die Foerderungsrollen (R) besonders angenaehrt sind, durchgefuehrt und bei dem, zur Vermeidung eines Ueberganges der flexiblen Leiterplatten in die Hohlraeume zwischen den Rollen, geeignete Abweiser aus Metall, sowie geeignete (an sich bekannte) Zungen eingefuehrt werden, welche die flexiblen Leiterplatten und die innerlayers dazu zwingen, immer und genau zwischen die Rollenpaare hindurchzugehen.

PATENTANSPRUECHE

- 1. Verfahren zur Herstellung von flexiblen und halbstarren Leiterplatten, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiterplatten dem Verfahren kontinuierlich senkrecht unterzogen werden, und zwar innerhalb von Becken, die chemische Produkte enthalten.
- 2. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten gemaess Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Transportsystem das chemische Entwicklunsprodukt auf den Oberflaechen der flexiblen Leiterplatten (Zone 1) laufend bewegt und erneuert, was auch in den Spuelungszonen (Zone 2) erfolgt.
- 3. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten gemaess Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die warme Luft in der Trocknungszone (Zone 3) um die flexiblen Leiterplatten zwangsweise geblasen wird.
- 4. Maschine zur Herstellung von Leiterplatten, dadurch gekennzeichnet, dass das kontinuierliche senkrechte Foerdersystem besonders naheliegende Transportrollen (R) verwendet.



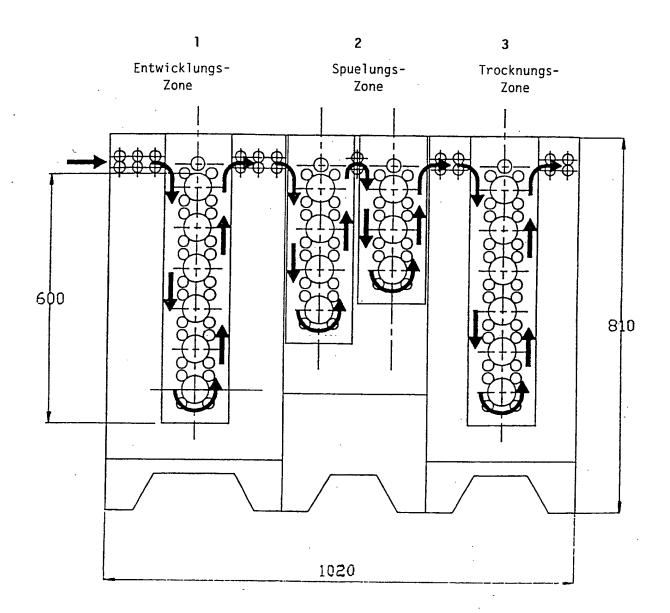


FIG. 2

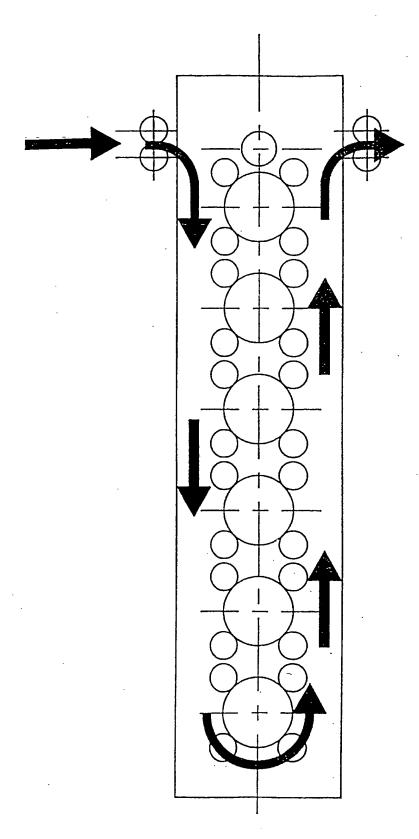


FIG. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter anal Application No PCT/EP 98/07659

A. CLASSI IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER H05K3/00		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classificat H05K	ion symbols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields se	arched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	use and, where practical, search terms used)	
		·	
0.000	CATO CONCIDENTA TO RE OF EVANT		
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	1	Deleverate state Ma
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
X	GB 1 104 100 A (ROGERS CORPORATION See page 4, line 75 - line 92; f		1-3
X	GB 822 826 A (ST. REGIS PAPER COI see page 2, line 109 - page 3, 1 figure 1		1,2
X	GB 1 233 401 A (ELECTRO CONNECTI SYSTEMS) 26 May 1971 see page 2, line 118 - page 3, 1 figure 1	4	1,2
	_ 	-/	
	·		V-
X Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed i	n annex.
° Special ca	tegories of cited documents ;	PTU Jakan da sama kata kata aka isan	
consid	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	"T" later document published after the inter- or priority date and not in conflict with to cited to understand the principle or the invention	the application but
"E" earlier o	ocument but published on or after the international ate	"X" document of particular relevance; the cl cannot be considered novel or cannot	
which ·	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	involve an inventive step when the doc "Y" document of particular relevance; the cl	cument is taken alone aimed invention
"O" docume	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an inv document is combined with one or mo	re other such docu-
	ant published prior to the international filing date but	ments, such combination being obviou in the art.	
	nan the priority date claimed actual completion of the international search	"&" document member of the same patent f Date of mailing of the international sea	·
		16/04/1999	•
	0 March 1999		
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5618 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fay: (+31-70) 440-3016	Mes, L	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte: onal Application No
PCT/EP 98/07659

0.40===4!=		T/EP 98/	0,009
Category 3	ction) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	F	Relevant to claim No.
(J.L. HARVEY ET AL.: "The manufacture of flexible printed wiring" WESTERN ELECTRIC ENGINEER, vol. 8, no. 3, July 1964, pages 2-10, XP002098354 New York see figures 1,9		1-3
			
		-	
		·	-
:		·	,
	•	,	•

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

.rormation on patent family members

interr nal Application No
PCT/EP 98/07659

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB 1104100 A		1	NONE	
GB 822826	Α	A NONE		
GB 1233401	Α	26-05-1971	DE 1765645 A FR 1580359 A NL 6809222 A	26-08-1971 05-09-1969 30-12-1968

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte onales Aktenzeichen
PCT/FP 98/07659

			101/11	36/0/033
A. KLASSI IPK 6	Fizierung des anmeldungsgegenstandes H05K3/00			
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	ifikation und der IPK	. <u> </u>	
	RCHIERTE GEBIETE			
IPK 6	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole H05K	9)		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	eit diese unter die rech	erchierten Geb	olete fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und	evti. verwend	ete Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommer	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	GB 1 104 100 A (ROGERS CORPORATION siehe Seite 4, Zeile 75 - Zeile 92 Abbildung 1			1-3
X	GB 822 826 A (ST. REGIS PAPER COMP siehe Seite 2, Zeile 109 - Seite 3 17; Abbildung 1			1,2
Х	GB 1 233 401 A (ELECTRO CONNECTIVE SYSTEMS) 26. Mai 1971 siehe Seite 2, Zeile 118 - Seite 3 47; Abbildung 1			1,2
	 -/	/	,	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang F	atentfamilie	
"A" Veröffer aber ni "E" älteres [C Anmeld "L" Veröffen scheine andere soll od ausgef "O" Veröffer eine Be" "P" Veröffer dem be	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist "Xullichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft eren zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ar die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ührt) titichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht tilichung, die vor dem intermationalen Anmeldedatum, aber nach sanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	oder dem Prioritätsd Anmeldung nicht kol Erfindung zugrundel Theorie angegeben i "Veröffentlichung von kann allein aufgrund erfinderischer Tätigk "Veröffentlichung von kann nicht als auf en werden, wenn die Ve Veröffentlichungen d diese Verbindung für "Veröffentlichung, die	atum veröffent lidiert, sonderr legenden Prinz ist besonderer Be dieser Veröffe eit beruhend b besonderer Be finderischer Tä inderischer Tä pröffentlichung lieser Kategori r einen Fachm. Mitglied dersei	deutung; die beanspruchte Erfindung titigkeit beruhend betrachtet mit einer oder mehreren anderen e in Verbindung gebracht wird und ann naheliegend ist ben Patentfamille ist
	Doubschlusses der internationalen Recherche März 1999	Absendedatum des i		necherchenderichts
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bei	diensteter	· ·

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter inales Aktenzeichen
PCT/EP 98/07659

X J.L. HARVEY ET AL.: "The manufacture of flexible printed wiring" WESTERN ELECTRIC ENGINEER, Bd. 8, Nr. 3, Juli 1964, Seiten 2-10, XP002098354 New York siehe Abbildungen 1,9	n Teile	Betr. Anspruch I	
flexible printed wiring" WESTERN ELECTRIC ENGINEER, Bd. 8, Nr. 3, Juli 1964, Seiten 2-10, XP002098354 New York		1-3	
•			
	•		
			,
;			
,			
·			•
•			
	•		
•			
•			
			•

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichur " on, die zur selben Patentfamilie gehören

Interi lales Aktenzeichen
PCT/EP 98/07659

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument GB 1104100 A		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
		KEINE				
GB 822826	GB 822826 A			KEINE		
GB 1233401	A	26-05-1971	DE FR NL	1765645 A 1580359 A 6809222 A	26-08-1971 05-09-1969 30-12-1968	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.